

表 補助金制度の対象分野・品目

対象分野・品目	補助金の性質
<b>A. サブアッセンブリ</b>	売上連動型補助金
ディスプレーモジュール カメラモジュール	
<b>B. ベアコンポーネント</b>	売上連動型補助金
非表面実装デバイス（NSMD）受動部品 エレクトロメカニカル 多層プリント基板（PCB） リチウムイオン電池セル（デジタルアプリケーション用。蓄電池や自動車用は除く） モバイル、ITハードウェア用のエンクロージャ	
<b>C. 特定ベアコンポーネント</b>	ハイブリッド補助金
HDI、MSAP、フレキシブル基盤（PCB） SMD受動部品	
<b>D. サプライチェーンエコシステムおよび資本的設備</b>	設備投資補助金
上記A～Cに使用される部品 エレクトロニクス製品生産に使用される資本品	

(出所) インド政府公表資料よりジエトロ作成